

Willkommen bei O-Leading

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Einzelne Produktreihe, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Leading
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupferdicke	0,5 oz-5 oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenveredelung	Immersionsgold, OSP, bleifreies HASL	Preis	\$ 0,1- \$ 10
anwendbar auf	LED, Handy, Klimaanlage, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerungsplatine
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg bis 5 kg	MOQ	10 stück
Farbe	blau, rot, grün, schwarz	Brettstärke	0,1-5 mm
Modell-Nr	pcba-hersteller von energienbanken	Größe	0,01m3-10m3
Design-Typ	Kundenanforderung	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen:	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferung Detail:	7-12days

Produktbeschreibung

16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenfertigung

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe

Schichtanzahl	32	42	38	44	42	48
Min Line / Abstand (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Beliebige Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung über	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kernstärke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laser Bohrer Durchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt via	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					
Embedded-Kondensator-PCB	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Immersionssilber, Immersionsdose, Flash-Gold, Vergoldung mit Finger, Selektive Hartvergoldung, Abziehbare Lötmaske, Carbon-Tinte					



www.o-leading.com

Hochwertige Leiterplattenfertigung

Unser Team





Zertifizierungen

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferungsdetails	7-12days



FAQ

1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostenreduzierung, der Vermeidung von Verschwendung und der Verbesserung der Effizienz bei. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden?

Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers, Arlon, Telfon, Platinen auf Aluminium- / Kupferbasis, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Inneres AOI → Multi-Bond → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Äußerer Trockenfilm → Musterplattieren → Äußeres Ätzen → Äußeres AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächenfinish → Routing → E / T → Sichtprüfung.